

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
3. Oktober 2002 (03.10.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/077985 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G11B 7/26**,
B29C 65/48 // B29L 17/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP02/02213

(22) Internationales Anmeldedatum:
1. März 2002 (01.03.2002)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
101 13 833.4 21. März 2001 (21.03.2001) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **STEAG HAMATECH AG** [DE/DE]; Ferdin-
and-von-Steinbeis-Ring 10, 75447 Sternenfels (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **HUPP, Alexander**

[DE/DE]; Just. Kerner Strasse 2, 75056 Sulzfeld (DE).
SPEER, Ulrich [DE/DE]; Sennigstrasse 6/2, 75239 Eising-
en (DE). **WAGNER, Roland** [DE/DE]; Hirschstrasse
19, 75015 Bretten (DE). **MICHELS, Frank** [DE/DE];
Schillerstrasse 49D, 75438 Knittlingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CA, CN, IL, JP, KR, SG,
US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE, TR).

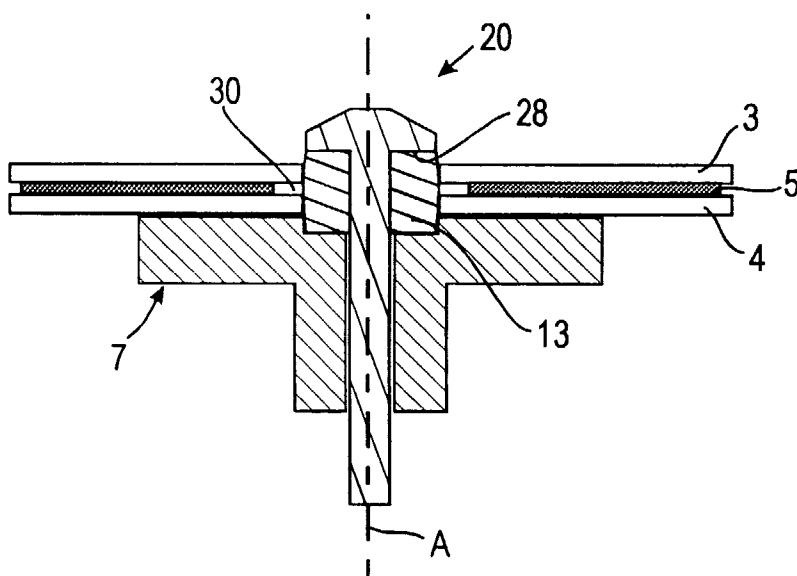
Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: DEVICE FOR JOINING SUBSTRATES

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM ZUSAMMENFÜGEN VON SUBSTRATEN



(57) Abstract: The invention relates to a device for joining substrates (3, 4) having an inner whole to give a wafer. The aim of the invention is provide a simple and inexpensive device that allows for a simultaneous rotation of the two substrates (3, 4) during gluing. To this end, the device has an element that can be inserted in the inner whole of at least two superimposed substrates (3, 4) and that can be expanded to close an interstice (30) between the substrates.

(57) Zusammenfassung: Um eine Vorrichtung zum Zusammenfügen von ein Innenloch aufweisenden Substraten (3,4) zu einer Substratscheibe zu schaffen, die auf einfache und kostengünstige Weise eine gleichzeitige Drehung beider Substrate (3,4) während des Verklebevorgangs gewährleistet,

weist die Vorrichtung ein in das Innenloch von wenigstens zwei übereinander liegenden Substraten (3,4) einführbares Element auf, das zum Schliessen eines Zwischenraums (30) zwischen den Substraten aufweitbar ist.



WO 02/077985 A1